



### ■ 許容損失について (QFN0404-24B)

QFN0404-24Bパッケージの許容損失について特性例を示します。

なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

測定条件

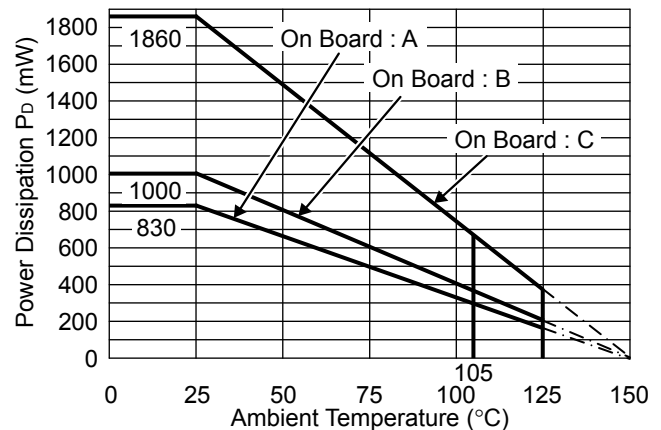
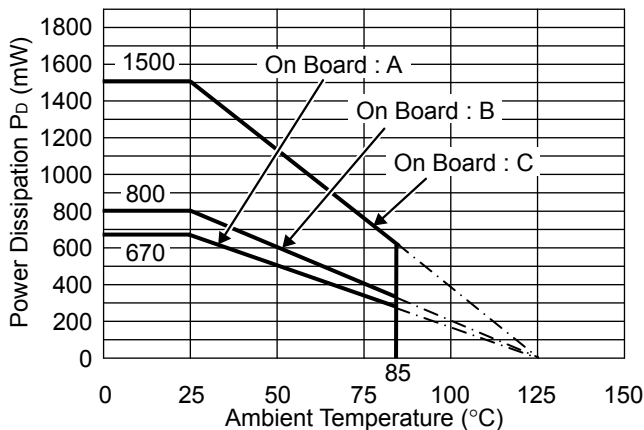
	A基板実装条件	B基板実装条件	C基板実装条件
測定状態	基板実装状態 (風速 0 m/s)		
基板材質	ガラスエポキシ樹脂 (両面基板)		
基板サイズ	40 mm × 40 mm × 1.6 mm		
配線率	表面 約50%、裏面 約50%	表面 約90%、裏面 約90%	表面 約50%、裏面 約100%
スルーホール	直径0.25 mm × 24個	直径0.25 mm × 24個	直径0.25 mm × 33個
備考	—	—	タブと裏面パターンを直径0.25 mmのスルーホール9個で接続

測定結果 (Ta=25°C)

	A基板実装条件	B基板実装条件	C基板実装条件
許容損失	670 mW (Tjmax=125°C) 830 mW (Tjmax=150°C)	800 mW (Tjmax=125°C) 1000 mW (Tjmax=150°C)	1500mW (Tjmax=125°C) 1860mW (Tjmax=150°C)
熱抵抗値	$\theta_{ja} = 150^{\circ}\text{C/W}$ $\theta_{jc} = 15^{\circ}\text{C/W}$	$\theta_{ja} = 125^{\circ}\text{C/W}$	$\theta_{ja} = 67^{\circ}\text{C/W}$

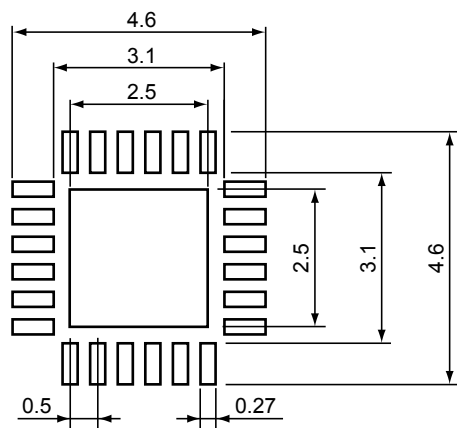
Tjmax = 125°C

Tjmax = 150°C

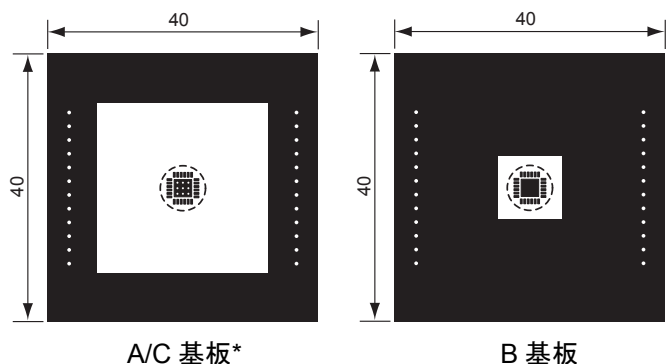


許容損失 対 周囲温度

### ■ 基板パッド推奨寸法 (QFN0404-24B)



(単位 : mm)



\* (○)内のスルーホール9個はC基板のみ

測定用基板レイアウト

○ IC実装位置(単位:mm)